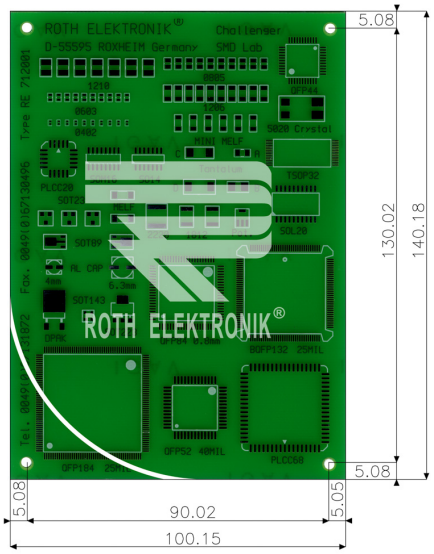

RE712001-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y evestido de laca inhibidora de soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes

- placa de circuito impreso con 85 componentes SMD para ejercicios de soldadura SMD estándar, "Fine Pitch" y componentes discretos:

tipo	**número**
PLCC	52, 68, 20
QFP	44, 84, 132, 184 sq.
SOT23	3 x
SOT89	2 x
SOT143	1 x
SOT233	1 x
SO14	1 x
SOM16	1 x
SOL20	1 x
Poti.	1 x
DPAK	1 x
Al. Kond. 6,30 mm	1 x
Al. Kond. 4,00 mm	1 x
Melf 2308	2 x
Mini Melf 1206	6 x
Tantal Chip Kond. A	1
Tantal Chip Kond. B	1
Tantal Chip Kond. C	1
Tantal Chip Kond. D	1
0402 Chip Kond.	10 x
0603 Chip Kond.	10 x
1206 Chip Kond.	10 x
0805 Chip Kond.	10 x
1210 Chip Kond.	7 x
2220 Chip Kond.	1 x
1812 Chip Kond	2 x
TSOP32	1 x
5020 Schwingquarz	1 x

- Muy adecuada también para la dotación automática Pick & Place)
- Tamaño: 100 x 140 mm

072025